

证券代码：688368

证券简称：晶丰明源

公告编号：2026-086

上海晶丰明源半导体股份有限公司

关于对外投资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 投资标的名称：**粤芯半导体技术股份有限公司（以下简称“标的公司”、“粤芯半导体”）
- 投资金额：**上海晶丰明源半导体股份有限公司（以下简称“公司”）以自有资金出资，参与粤芯半导体首次公开发行股票战略配售，认购金额不超过人民币 5,000 万元
- 交易实施尚需履行的审批及其他相关程序：**本次对外投资事项在公司董事会决策权限内，无需提交股东会审议。
- 其它需要提醒投资者重点关注的风险事项：**粤芯半导体面临复杂的市场竞争环境；募集资金投资项目的投资进度、建设过程和投资收益等可能存在一定的不确定性；粤芯半导体的股价受多种因素影响可能产生波动，进而会影响公司的投资收益。敬请广大投资者注意投资风险。

一、对外投资概述

（一）本次交易的基本情况

1、本次交易概况

为加强公司与粤芯半导体的战略合作关系，进一步提升公司的核心竞争力，同时提高公司自有资金使用效率，为公司及股东谋求更多利益，公司将作为战略

投资者以自有资金参与认购粤芯半导体首次公开发行战略配售的股份，认购金额不超过人民币 5,000 万元。根据标的公司 2026 年 9 月 23 日披露的《粤芯半导体技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》，粤芯半导体本次发行价格为 12.01 元/股，公司获配股数为 4,163,197 股，获配金额为 49,999,995.97 元，本次获配股数占粤芯半导体本次发行数量 512,646,000 股的比例为 0.81%，占粤芯半导体首次公开发行后总股本（超额配售选择权行使前）2,878,237,397 股的比例为 0.14%。

2、本次交易的交易要素

投资类型	☐新设公司 ☐增资现有公司（☐同比例 ☐非同比例） —增资前标的公司类型：☐全资子公司 ☐控股子公司 ☐参股公司 ☐未持股公司 ☐投资新项目 ☒其他：认购首次公开发行战略配售股份
投资标的名称	粤芯半导体技术股份有限公司
投资金额	☒ 已确定，具体金额（万元）：<u>4999.9996</u> ☐ 尚未确定
出资方式	☒现金 ☒自有资金 ☐募集资金 ☐银行贷款 ☐其他：_____ ☐实物资产或无形资产 ☐股权 ☐其他：_____
是否跨境	☐是 ☒否

（二）本次交易的审议情况

公司于 2026 年 6 月 26 日召开第四届董事会第六次会议，以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于拟参与粤芯半导体技术股份有限公司首次公开发行战略配售的议案》。根据《上海晶丰明源半导体股份有限公司章

程》（以下简称“《公司章程》”）及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，本次对外投资事项在公司董事会审批权限内，无需提交股东会审议。

鉴于本次投资事项为参与认购粤芯半导体首次公开发行战略配售，属于临时性商业秘密，根据《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，并经董事会秘书、董事长签字确认，公司就本次对外投资事项暂缓披露，并于标的公司 2026 年 9 月 23 日披露《粤芯半导体技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》后及时履行信息披露义务。暂缓披露期间公司股票交易未发生异常波动的情形。

（三）本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。

二、投资标的基本情况

（一）投资标的概况

粤芯半导体是一家致力于为境内外芯片设计企业提供 12 英寸晶圆代工服务和特色工艺解决方案的集成电路制造企业，其以特色工艺晶圆代工为核心商业模式，服务芯片设计公司和终端客户，主要客户涵盖境内外多家一流半导体行业设计公司，具备集成电路、功率器件等产品的工艺研发与制造能力，产品应用领域覆盖消费电子、工业控制、汽车电子和人工智能等。

（二）投资标的的信息

1、对外投资标的基本情况

投资类型	☒ 其他：认购首次公开发行战略配售股份
标的公司类型（增资前）	未持股公司
法人/组织全称	粤芯半导体技术股份有限公司
统一社会信用代码	☒ 91440101MA5AMY9D1D ☐ 不适用
法定代表人	陈谨

成立日期	2017 年 12 月 12 日
注册资本	236,559.1397 万元
注册地址	广州市黄埔区凤凰五路 28 号
控股股东/实际控制人	标的公司无控股股东、实际控制人
主营业务	集成电路代工、功率器件代工
所属行业	计算机、通信和其他电子设备制造业

2、对外投资标的（合并报表）最近一年又一期财务数据

单位：万元

科目	2025 年 12 月 31 日 (经审计)	2026 年 6 月 30 日 (未经审计, 经审阅)
资产总额	2,447,017.07	2,908,220.48
负债总额	2,058,569.13	2,126,109.51
归属于母公司所有者权益	265,184.18	168,449.47
资产负债率	84.13%	73.11%
科目	2025 年度 (经审计)	2026 年 1-6 月 (未经审计, 经审阅)
营业收入	258,236.87	177,736.51
归属于母公司所有者的净利润	-234,582.32	-105,188.98

注：上述财务数据来源为标的公司公开披露的《粤芯半导体技术股份有限公司 2023 年度、2024 年度、2025 年度审计报告》《粤芯半导体技术股份有限公司 2026 年 4-6 月财务报表审阅报告》《粤芯半导体技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书》。

3、对外投资标的股权结构

标的公司本次发行前后股权结构情况详见标的公司披露的《粤芯半导体技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书》中“十一、发行人的股本情况”之“（一）本次发行前后股本结构”的具体内容。

（三）出资方式及相关情况

本次出资方式为货币出资，资金来源为公司自有资金。

（四）其他

经查询公开信息，截至本公告披露日，标的公司不属于失信被执行人。

三、战略配售协议的主要内容

（一）协议主体

甲方：粤芯半导体技术股份有限公司

乙方：上海晶丰明源半导体股份有限公司

（二）认购价格：乙方不参与本次发行的网下初步询价，将以初步询价后发行人和联席主承销商最终确定的发行价格认购本次发行的股票。

（三）认购金额：乙方同意认购甲方首次公开发行的股票；甲方同意乙方作为首次公开发行的认购对象之一，认购金额最高不超过人民币 5,000 万元。

最终乙方实际获配股票数量由甲方依据实际发行情况进行调整，乙方承诺接受甲方对于乙方实际获配股票数量的调整结果。

（四）乙方最终获配股数及获配金额以发行公告为准。最终获配金额与认购资金的差额部分，保荐人（主承销商）将在指定日期之前，依据乙方缴款原路径无息退回。

甲方和联席主承销商将在网下初步配售结果公告中披露最终获配的参与战略配售的投资者名称、股票数量以及限售期安排等信息，公告一经刊出即视同已向乙方送达获配通知。

（五）乙方保证获得本次配售的股票持有期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 24 个月，承诺不通过任何形式在限售期内转让所持有本次配售的股票。

（六）违约责任：如果本协议一方违反本协议约定以致本协议未履行或不能充分履行，违约引起的责任应由违约方承担。如本协议一方违反本协议的声明或保证而使另外一方遭受损失的，违约一方应承担相应的赔偿责任。如果本协议双方均违约，双方应各自承担其违约引起的相应部分责任。

（七）争议解决方式：本协议的有效性、解释、履行及有关本协议的任何争议的解决，均适用中国法律。凡因履行本协议所发生的与本协议相关的一切争议，双方均应通过友好协商的方法解决。若在争议发生之日起 10 日内未能协商或经

协商未能解决的，任何一方均有权提交甲方住所地人民法院诉讼管辖。

（八）本协议的生效以下列全部条件的满足为前提：（1）本协议经甲乙双方法定代表人或其授权代表签章/签字并加盖公章；（2）经甲乙双方各自内部有权决策机构批准以及中国证监会针对甲方首次公开发行做出同意注册的决定。

本协议于中国证监会同意甲方首次公开发行股票注册的决定作出之日起 12 个月内有效，若在上述有效期内未完成本协议约定的配售事宜，则本协议于中国证监会同意注册的有效期满后自动终止。

四、对外投资对上市公司的影响

本次对外投资事项有利于加强公司与粤芯半导体的战略合作关系，优化公司的经营与业务布局，符合公司整体战略发展方向，有利于进一步提升公司核心竞争力；同时提高公司自有资金使用效率，为公司及股东谋求更多利益。

本次投资的资金来源为公司自有资金，不会对公司日常经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。

五、对外投资的风险提示

1、标的公司在未来经营过程中，可能面临工艺技术平台迭代不达预期、核心技术泄密、研发人员流失等技术风险，尚未盈利且存在累计未弥补亏损、市场开拓不及预期、新增产能无法及时消化、原材料价格波动、业绩未及预期等经营风险，经营业绩下滑、未来收入规模不及预期、存货跌价、政府补助政策变化、汇率波动等财务风险，以及宏观经济波动、行业周期性、市场竞争加剧、国际贸易摩擦等行业风险。

2、标的公司对募投项目进行了充分的分析和论证，但该可行性分析是基于当前市场环境、标的公司现有业务状况和未来发展战略等因素作出的，若前述因素发生重大变化，本次募集资金投资项目的投资进度、建设过程和投资收益等将

存在一定的不确定性。如果本次募集资金投资项目无法顺利实施，将对标的公司生产经营产生不利影响。

若标的公司工业级和车规级工艺技术平台开发遇到技术瓶颈、集成电路市场环境发生重大不利变化，或标的公司 12 英寸集成电路模拟特色工艺生产线项目（三期项目）产生的收入及利润水平未能实现既定目标，其新增的折旧和摊销或将对标的公司经营业绩产生一定的影响，延后其实现盈利的时间；若标的公司特色工艺技术平台研发项目研发失败或研发成果不达预期，则可能导致标的公司募投项目不能如期实施。

3、粤芯半导体本次发行的股票将在深圳证券交易所创业板上市，除其自身经营和财务状况外，股票价格还受到宏观政策、经济形势、资本市场走势、投资者心理等多种因素的影响，从而可能产生波动，进而影响公司的投资收益。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海晶丰明源半导体股份有限公司

董 事 会

2026 年 9 月 24 日